



ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

## **Digi International demonstriert auf der Embedded World 2017 die neusten Fortschritte bei den IoT-Technologien**

*Zum fünfzehnjährigen Messejubiläum der Embedded World demonstriert Digi  
der internationalen Community Company Leadership und Mission-Critical-  
Lösungen*

**PARIS, 7. März 2017** – Digi International®, (NASDAQ: DGII, [www.digi.com](http://www.digi.com)), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Machine-to-Machine (M2M) und IoT-Connectivity, kündigte heute die wichtigsten Aktivitäten und Veranstaltungen des Unternehmens im Rahmen der [Embedded World](#) an. Die Veranstaltung findet im Messezentrum Nürnberg vom 14.-16. März 2017 statt. Digi ist als Co-Aussteller in Halle 3 an den Ständen 3-141 und 3-310 vertreten.

Während der dreitägigen Veranstaltung werden Repräsentanten von Digi mehrere durchgängige Präsentationen und Vorführungen moderieren, die eine Reihe der Produkte von Digi für die M2M und das IoT vorstellen. Das Unternehmen wird seine Produktinnovationen erläutern und Einzelheiten seines demnächst verfügbaren ConnectCore® für i.MX6UL Einplatinencomputer, das Digi XBee® Cellular NB-IoT Modem und die Produktpläne für die LoRa-Spezifikation vorstellen. Digi wird zudem den Besuchern die Möglichkeit bieten, Starter und Development Kits des ConnectCore für i.MX6UL zu bestellen.

„Digi International und Embedded World arbeiten seit langem bei der Vorstellung marktorientierter Lösungen zusammen, die eine bahnbrechende Realisierung ermöglichen“, sagte Kevi C. Riley, Chief Operating Officer bei Digi International. „Als eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen ist die Embedded World der perfekte Ort, um neue Produkte vorzustellen, die die IoT-Branche voranbringen.“

### **Produktvorstellungen und Vorführungen**

Die Vertreter von Digi werden die aktuellen Lösungen demonstrieren, eine Vorschau über demnächst erscheinende Produkte bieten und Schulungsveranstaltungen durchführen, wie zum Beispiel:

- **ConnectCore 6UL System-on-Module (SOM)** – ConnectCore für i.MX6UL SOM ist als sichere und intelligente Embedded-Plattform konzipiert, die auf Gerätehersteller zugeschnitten ist, die extrem kostengünstige und zuverlässige verbundene Geräte produzieren, ohne dabei dem herkömmlichen Designrisiko bei der Hard- oder Software zu unterliegen. Auf Basis des NXP i.MX 6UltraLite Applikationsprozessors bietet das Modul den einzigartigen, zum Patent angemeldeten oberflächenmontierbaren Digi SMTplus™ Formfaktor, der nur wenig größer als eine Briefmarke ist. Es bietet zudem optional 802.11ac und Bluetooth 4.2 Wireless-Konnektivität, einen industriellen Betriebstemperaturbereich, zwei kostenoptimierte Integrationslösungen (LGA und Durchkontaktierungen mit metallisierten Kanten) sowie, in der Branche führende, ultra-low Powermodi bis zu 35 µA, die das Potential des nahtlos integrierten Microcontroller Assist™ (MCA) von Digi nutzen.
- **ConnectCore 6UL Single Board Computer (SBCs)** – Digi wird die Funktionen des demnächst verfügbaren ConnectCore für i.MX6UL Single Board Computer (SBC) in einer Vorschau präsentieren. ConnectCore 6 für i.MX6UL SBC liefert vorzertifizierte, gebrauchsfertige Einplatinencomputer mit drahtloser und drahtgebundener Konnektivität, Optionen zur Mobilfunk-Anbindung, einer kompletten Yocto-Project Linux-Unterstützung und einer vollständigen Integration der Digi TrustFence™ Device Security. Die Formfaktoren ConnectCore 6 für i.MX6UL SBC Pro (100 x 72 mm, Pico-ITX) und ConnectCore für i.MX6UL SBC Express (87 x 63 mm) sind optimierte Plattformen für eine große Bandbreite industrietauglicher Anwendungen und ermöglichen dramatisch beschleunigte Markteinführungszeiten, da kein benutzerdefiniertes Hardwaredesign mehr benötigt wird.
- **Digi XBee® Cellular NB-IoT** – Digi wird die europäische Version des Digi XBee Cellular vorstellen, das für das Cat NB-IoT konzipiert wurde. Optimiert für die Vodafone-Netze in Europa wird diese Version des Digi XBee es Originalherstellern (OEM) ermöglichen, das NB-IoT auf Mobilfunkbasis schnell und einfach in ihre Designs zu integrieren - mit einem zuverlässigen, kostengünstigen, niedrigen Stromverbrauch und einer zusätzlichen eingebauten Sicherheit.
- **Digi XBee® LoRa und Digi XBee® LoRaWAN™** - Mit der für 2017 geplanten Einführung auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten hat Digi mit der Entwicklung der Digi XBee sowohl für LoRa und LoRaWAN Wireless-Plattformen - einschließlich Embedded Module und Gateways - begonnen. Die Besucher der Embedded World sind eingeladen, bei den Vertretern von Digi vorbeizuschauen, um mehr über die Angebote und die Roadmap von Digi XBee LoRa zu erfahren.
- **Schulungsveranstaltungen** - Am Donnerstag, dem 16. März zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr wird Mike Rohrmoser, Leiter Produktmanagement Embedded Systems bei Digi International, im Rahmen der Veranstaltung 33 unter dem Titel „Auswahl des richtigen SOC / SOM für Wireless M2M Connectivity“ Neuigkeiten präsentieren. Diese

Veranstaltung wird über das System-on-Chip (SOC) und das System-on-Module (SOM) als ideale Plattform für ein schnelles und fokussiertes Produktdesign informieren.

- **MitAussteller und Beteiligung der Partner** - Digi präsentiert seine Lösungen auch zusammen mit seinen Partnern an den folgenden Standorten: Arrow Electronics (Halle 4A, Stand 4A-340), Atlantik Elektronik (Halle 3, Stand 3-141), CODICO (Halle 3, Stand 3-310), Digi-Key Electronics (Halle 4A, Stand 4A-631) und NXP Semiconductors (Halle 4A, Stand 4A-220).
  - **Standvorführungen** (Stände von Atlantik und CODICO)
    - ConnectCore für i.MX6UL – Die interaktive Demonstration zeigt die wichtigsten Merkmale des robusten ConnectCore für i.MX6UL SOM, zu denen Digi TrustFence™ -Sicherheit, Ultra-Low-Power-Betrieb, Sensorintegration, Cloud-Konnektivität, Display-Integration und die Fähigkeit, eine Benutzeroberfläche zu unterstützen, gehören.
    - Digi XBee ZigBee – Diese Demo zeigt eine cloudverbundene Industriebeleuchtungs-Anwendung einschließlich Digi XBee ZigBee-Modul und Digi XBee ZigBee-Gateway, um eine Beleuchtungs-Lösung, die ein Wireless-Mesh nutzt, zu schaffen, die aus der Ferne überwacht und gesteuert werden kann.

Die ConnectCore für i.MX6UL Starter- und Development Kits und Mustermengen der Module sind derzeit verfügbar. Das Datum für die allgemeine Verfügbarkeit der Modulfertigungsaufträge ist der 30. März 2017. Besucher der Embedded World können das ConnectCore für i.MX6UL Developer-Kit bei Partnern zum Embedded World-Sonderpreis von 99,00 USD (UVP 249,00 USD) bestellen.

### **Über Digi International**

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als 100 Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Digi unter [www.digi.com](http://www.digi.com) oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international.)

### **Pressekontakt:**

Europa

Vibeke Ulmann

**Digi International demonstriert auf der Embedded World 2017 die neusten Fortschritte bei den IoT-Technologien**

**7. März 2017**

**Seite 4**

Catalyst Communications

Geschäftsstelle: +44 (0)1323 760 335

[vibeke.ulmann@catalystpr.com](mailto:vibeke.ulmann@catalystpr.com)

Nordamerika

Rick McLaughlin

LEWIS

Geschäftsstelle: +1 781-418-2402

[rick.mclaughlin@teamlewis.com](mailto:rick.mclaughlin@teamlewis.com)